

NUMBER 1318195

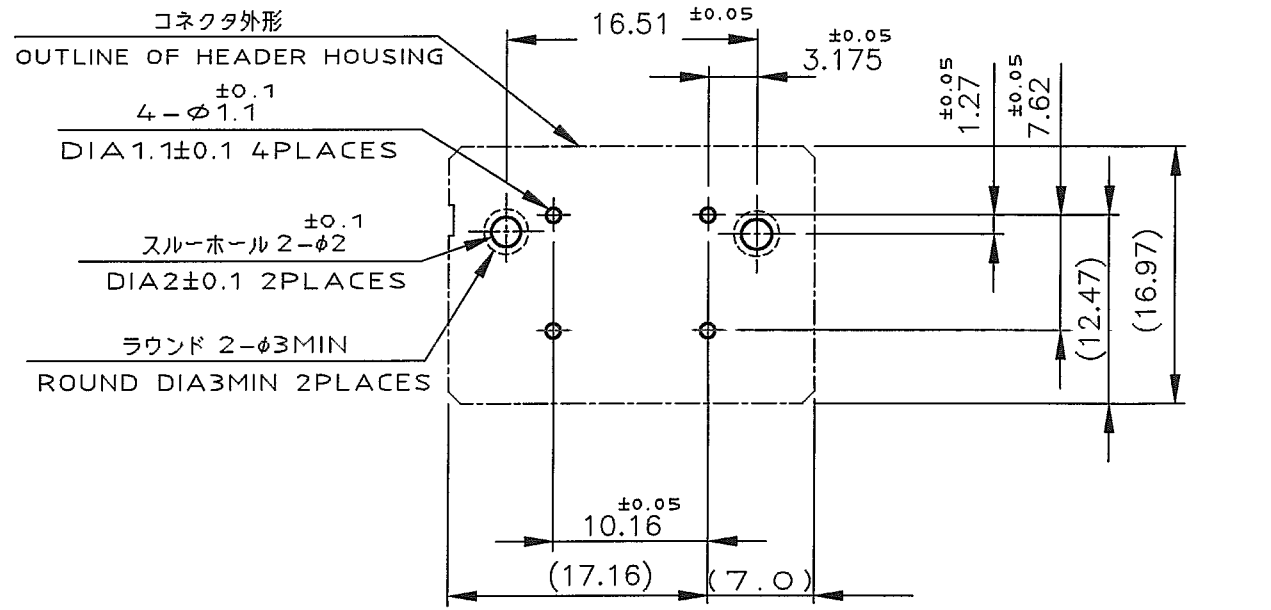
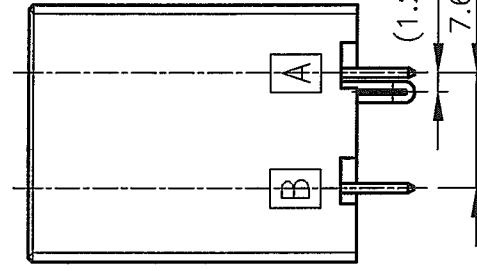
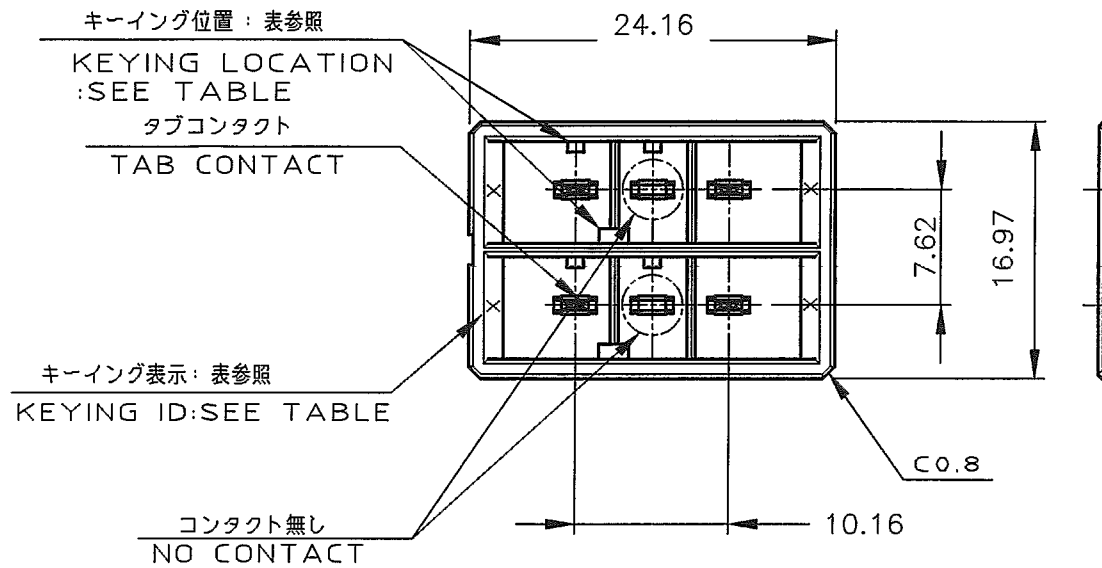
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

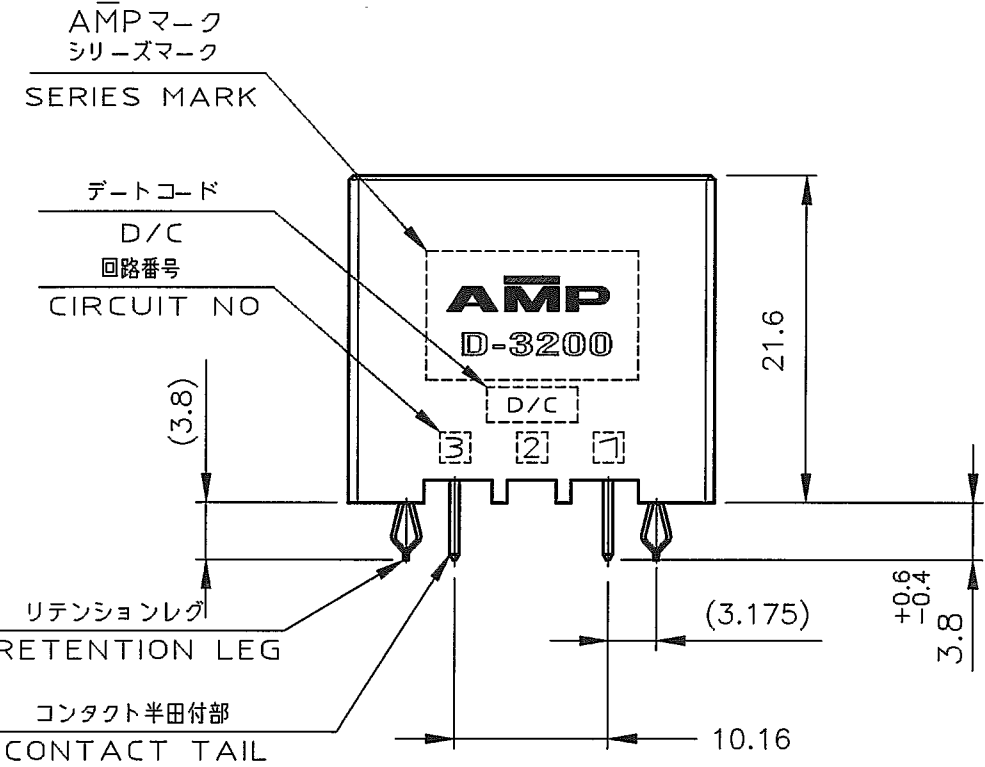
PRINT DIST

AMP-J REV.10/'83



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- 2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- 3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- 4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- 5. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 6. FOR DRAWER

注記

- 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- 2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- 3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- 4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- 5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき
- 6. 枠用

KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
A ROW			4	3-1318195-5	
B ROW	X	Y	3	3-1318195-3	
			2	3-1318195-2	
A ROW			4	2-1318195-5	
B ROW	Y	Y	3	2-1318195-3	
			2	2-1318195-2	
			2	4-1318195-2	6
A ROW			5, 4	1-1318195-5	
B ROW	X	X	3	1-1318195-3	
			2	1-1318195-2	

				Copyright © 1994 Tyco Electronics AMP K.K. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME			
mm ² (AWG -)		mmφ		DYNAMIC D-3200M 4 POS VERTICAL-HDR ASS'Y			
MATERIAL		FINISH		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		SIZE LOC NUMBER			
DR. 20/OCT/'98		DE. 20/OCT/'98		A3 J C= 1318195			
CHK. 21 OCT 98		APP. K.IKEDA		SCALE REV. SHEET			
N.MATSUBARA				2-1 A 1 OF 1			

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面